

# 第1回 AM Worldセミナー

## ～日本のAM技術の普及に向けて～

導入検討者から熟練者まで、未来の製造業を見据えたAMセミナー!

AM技術導入の課題から解決方法まで、実践的ワークショップ形式で学ぶチャンス。

同時開催で、国内外の金属AM技術のスペシャリストが各業界の最新AM適用事例をご紹介します!

(AM: Additive Manufacturing 3Dプリンタのこと)

2024年10月15日(火) 10:00~17:30  
(受付開始 9:30)

場所/慶應義塾大学

三田キャンパス 西校舎518教室

※詳細は裏面をご確認ください

定員

400名

定員に達し次第、  
締め切り

未来のエンジニアを応援! 学生参加は無料!



### 講演プログラム

司会進行: セミナー実行委員長、慶應義塾大学 准教授 小池 綾氏

時間	講師	テーマ
10:00~10:10	AM部会長、大阪大学 理事・副学長 田中学氏	開会のご挨拶
10:10~11:20	金属AM初心者運用講座とワークショップ AM部会広報委員会主催 ※ワークショップの概要は裏面をご確認ください	
11:20~12:00	FhG IAPT Mr. K.Janzen Dr. L.Waalkes 	「New Advancements in Metal Binder Jetting」<英語講演> 最近量産分野で注目を集めているM.B.J.(Metal Binder Jet)の最新技術を持続可能性とコスト削減に焦点を当てて紹介する。
12:00~13:00	昼休憩 ※ご昼食は各自でお済ませください。学食はご利用できます。会場内でのご飲食はできません。	
13:00~13:40	経済産業省 素形材産業室 室長 星野 昌志氏 	「素形材産業を巡る動向とAMへの期待」 ものづくりのゲームチェンジャーとなりうる金属積層造形技術の現状と、今後の期待について述べる。
13:40~14:20	三菱重工業株式会社 常務執行役員 CTO兼CoCSO 伊藤 栄作氏 	「設計・製造プロセスを革新するAM技術」 当社で実践されているDfAMの様々な機能への反映と、目指すべきAM品質保証の在り方を述べる。
14:20~15:00	株式会社ニコン 代表取締役 兼 会長執行役員 CEO 馬立 稔和氏 	「NikonのAM戦略」 大型・高生産性を狙うSLM大型機と、開発中の高精細・高生産性を狙う革新的なSF-DED技術を紹介する。
15:00~15:20	休憩	
15:20~16:00	慶應義塾大学 准教授 小池 綾氏 	「宇宙AM-異重力場で拓くAM技術の新展開」 アカデミアから見た日本のAMIに対する期待と、今後のAM技術の宇宙産業での展開を語る。
16:00~16:40	HBD Mr. Rodgers Ma Mr. Deng Pu 	「中国におけるAM市場と品質保証」<中国語講演・通訳あり> 欧米で採用されたHBDの品質管理技術を示すとともに、中国でのAM技術の現状を語る。
16:40~17:20	集中討議「AM品質保証」 阿久津 光雄氏(埼玉車体株式会社) 木寺 正晃氏(愛知産業株式会社)	
17:20~17:30	セミナー実行委員長、慶應義塾大学 准教授 小池 綾氏	閉会のご挨拶

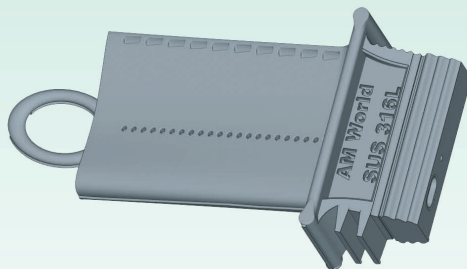
# ワークショップ概要 10:10~11:20、12:00~13:00(お昼の休憩時間)

初めてAMに接する方を対象に、AM造形プロセスを考慮したAM設計を体験するとともに、AMの難しさと従来プロセスに対する優位性の両方を実体験できるワークショップを開催いたします。

- ①造形用データ準備 ②問題点抽出(造形・仕上)  
③データ修正 ④造形 ⑤測定 ⑥仕上加工 ⑦完成

一貫してAMの製造工程を体験することが可能です。

AM部会は、AM教育から国際認証獲得まで、  
一貫した育成プログラムを提供いたします。



## 開催概要

日程 2024年10月15日(火)

時間 10:00~17:30(受付開始9:30)

※途中に昼休憩がございます。  
ご昼食は各自でお済ませください。  
学食はご利用できます。会場内でのご飲食はできません。

場所 慶應義塾大学 三田キャンパス 西校舎518教室  
(東京都港区三田2丁目15-45)

アクセス 田町駅(JR山手線・京浜東北線)徒歩8分  
三田駅(都営地下鉄浅草線・三田線)徒歩7分  
赤羽橋駅(都営地下鉄大江戸線)徒歩8分

定員 400名(定員に達し次第、締め切り)

締切 **2024年10月7日(月)正午**

受講料 **溶接協会会員・後援団体会員15,000円(税込/1名) 非会員:20,000円(税込/1名)**  
**学生無料(事前の申込みが必要です)**

※当日申込みは不可

※後援団体(下記に記載)所属の方は会員価格でご参加いただけます。

※学生は28歳まで。当日受付けで学生証をご提示いただけます。

詳細お申込み <https://www.jwes.or.jp/committees/am/seminar/>

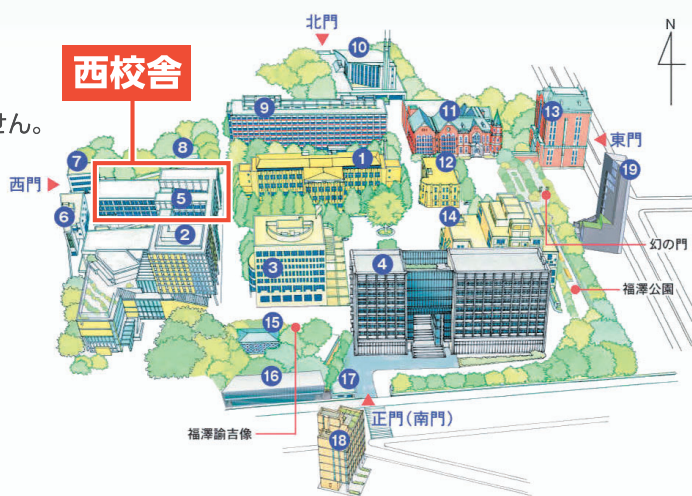
※受付けはオンライン専用となります。

上記の日本溶接協会専用ページの「★お申込み」から該当のセミナーをご選択いただき、所定の事項に記載下さい。

お申込み後の確定メールにて、お支払先、請求書、領収書等のご案内をいたします。

※講演資料は参加者へ事前に電子配信します(当日の配布はございません)。

## 三田キャンパス



主催  日本溶接協会 AM部会

後援  一般社団法人 日本AM協会   一般社団法人コンピュータ教育振興協会  
Association for Computer Skills Promotion

AM研究会 一般社団法人溶接学会 公益財団法人溶接接合工学振興会 レーザ加工学会 他  
※後援団体の詳細は、日本溶接協会専用ページ(上記URL)よりご確認ください。(2024年9月5日時点)

協力   



一般社団法人日本溶接協会 AM部会担当事務局  
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-20  
TEL:03-5823-6324

